

46-956 / 46-957 Economy Version

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.64mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	1000 MΩ min.
Insulation Resistance	1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	1000 V AC/DC
Test Voltage	1000 V AC/DC
Nennstrom	3.0 A
Current Rating	3.0 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



© W+P PRODUCTS

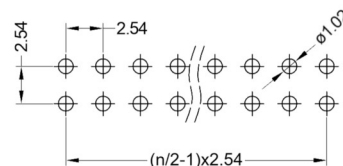
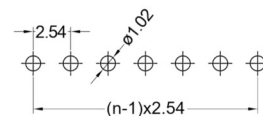
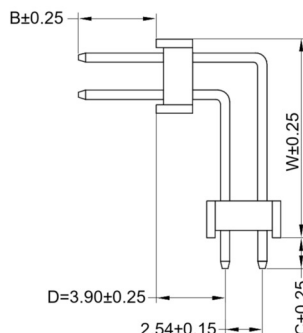
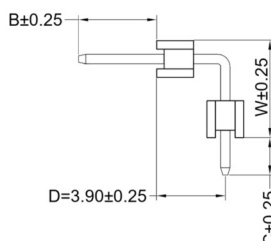
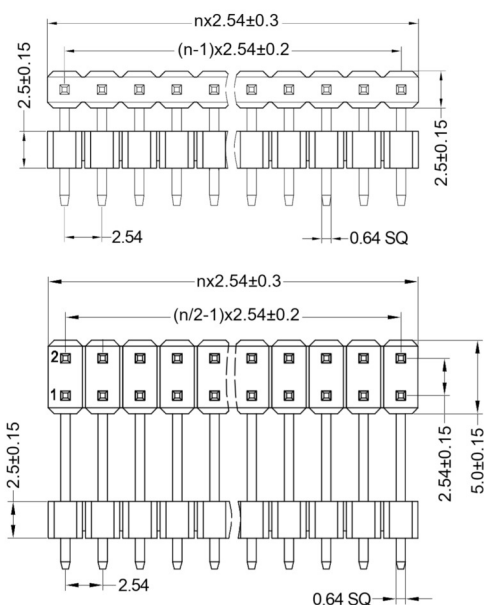
Passende Buchsenleisten:

Compatible Female Headers:

153 154 46-157 46-159 46-160 / 46-162 46-624 etc.

Weitere siehe Kapitel B

Please see ch. B for more



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)

Series*

46-956

46-956 Einreihig
Single row
46-957 Zweireihig
Double row

Dimensions*

12

12 B=4.60 C=3.30 D=3.9 W=13.50mm
13 B=4.80 C=3.30 D=3.9 W=16.80mm
99- Kundenspezifisch
Customer-specific

Contacts*

016

001-020 Einreihig
Single row
004-050 Zweireihig
Double row

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

